산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	**보 도 자 료**	보도시점 맞춤형 정책

2018년 11월 30일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 11. 29.(목) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2018. 11. 29.(목)	담당부서	전자부품과
담당과장	박영삼 과장(044-203-4270)	담 당 자	김성환 주무관(044-203-4276)

전자부품업계와 기계·로봇업계간 만남의 장 열린다
- 전자부품-기계·로봇 융합 얼라이언스 출범 -

□ 산업통상자원부(장관 성윤모)는 '18.11.29(목) 15시 판교 메리어트호텔에서 「**전자부품-기계·로봇 융합 얼라이언스**」 **출범식**을 가졌다.

○ 이번 행사는 반도체, 디스플레이, 센서 등 전자부품의 대표적인 수요처인 **기계·로봇 업계와의 교류·협력을 증진**하기 위해 마련했으며,

○ 전자부품 분야 11개 기업, 기계·로봇 분야 10개 기업, 전자부품 연구원 등 7개 유관기관 등에서 약 30여명이 참석했다.

□ 산업부는 우리 전자부품업계가 4차 산업혁명 시대 **수요변화에 맞춰 새로운 성장 품목을 지속적으로 발굴**할 수 있도록 올 2월 전자부품 산업과 **5대 수요산업간 융합 얼라이언스 구축계획을 발표**했다.

* 전자부품 5대 수요산업 : 자동차, 바이오·의료기기, 가전, 에너지, 기계·로봇

○ 그간 자동차(5월)를 시작으로 바이오·의료기기(6월), 사물인터넷(IoT) 가전(9월), 에너지신산업(10월)과의 얼라이언스를 출범시킨바 있으며, 이날 기계·로봇 분야와의 얼라이언스를 출범식을 갖는 것이다.

<기 출범 전자부품 융합얼라이언스 참여기업 현황>

구 분	참여기업		
	수요기업	공급기업	
자동차(5월)	▪ 대양, 만도 등 5개	▪ 반도체: 텔레칩스 등 11개	▪ 디스플레이: 엘케이 등 10개
바이오·의료(6월)	▪ 보템, 윈텍 등 5개	▪ 반도체 : 옵토레인 등 4개	▪ 디스플레이: 파인텍 등 10개
IoT가전(8월)	▪ 대우전자, 코웨이 등 5개	▪ 반도체 : 라온텍 등 4개 ▪ 임베디드SW: 그립 등 5개	▪ 디스플레이: 아바코 등 3개 ▪ 센서: 햅트릭스 등 3개
에너지 신산업(9월)	▪ LS산전, 등 7개	▪ 반도체 : 씨자인 등 4개 ▪ 임베디드SW: 지케스 등 3개	▪ 디스플레이 : 머크 등 7개 ▪ 센서: 에스앤에이 등 2개

□ 최근 등장하고 있는 **기계·로봇 제품**들은 인공지능(AI)처리 반도체, 첨단 센서, 착용형(웨어러블) 디스플레이, 경량형 임베디드 소프트웨어(S/W) 등 **새로운 전자부품들을 더욱 많이 필요**로 하고 있다.

<다수의 전자부품이 들어가는 사례 : 음성·사물인식 Picking 로봇>



○ 이에 산업부는 수요기업과 공급 기업이 **연구개발(R&D) 공동기획*** 등을 통해 기계, 로봇 제품개발 초기단계부터 상호 협력할 수 있도록 유도하기로 했다.

* '19년 신규사업(안) : 차세대반도체기술개발사업, 산업용임베디드시스템기술개발 등

○ 아울러, 산업부는 국내기업과의 수요연계 뿐만 아니라 세계적인 **기계, 로봇 유수기업과도 기술·구매 협력**이 가능하도록 국제 **네트워킹 행사를 개최할 예정이다.**

□ 이날 행사에 참석한 산업부 강경성 소재부품산업정책관은, “우리나라가 4차 산업혁명을 선도해나가기 위해서는 **산업간 융합과 협업이 필수적이다.**”라고 강조하면서

○ “**전자부품 융합 얼라이언스**가 **산업간 융합과 협업의 거점 역할**을 할 수 있도록 **정부에서도 관심과 지원**을 아끼지 않겠다.“라고 말했다.

【붙 임】 1. 행사 개요　2. 얼라이언스 참여기관 현황



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 전자부품과 김성환 주무관(☎ 044-203-4276)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1 **행사 개요**

□ 행사개요

○ (일시/장소) 11.29일(목) 15:00~17:00 / 메리어트호텔(성남)

○ (참석자) 산업부, 전자부품연구원, 기계산업진흥회, 로봇산업협회, 전자부품 관련 협회, 산업기술평가관리원, 관련 기업 등 30여명

○ 세부 계획(안)

시 간	내 용	비 고
15:00~15:05(05′)	- 개회	
15:05~15:25(20′)	- 미국 기계/로봇 분야 성능/안전 평가 프로세스 등 동향	· NIST(미국표준기술연구원)
15:25~15:45(20′)	- 협동로봇 시장전망/기술동향 및 한국기업과 비즈니스 협력	· 유니버셜로봇
15:45~16:00(15′)	- 휴식	
16:00~16:15(10′)	- 얼라이언스 출범 그간 경과 및 향후 계획 발표	· KETI
16:15~17:00(45′)	- 얼라이언스 간담회	· 참석자
17:00~	- 기념 촬영 후 종료	

붙임2 **전자부품 융합 얼라이언스(기계·로봇분과) 참여기관 현황**

□ **전자부품수요기업**(기계·로봇기업)과 **전자부품공급기업**(반도체·디스플레이·임베디드SW·센서기업) 관련 협·단체 등으로 구성

구분		소속	성명	직책
수요기업	기계(6)	워터닉스	전원배	대표
		대현하이드로릭스	이승현	기술고문
		드라이브텍	최윤용	대표
		성보 P&T	황상목	상무
		오토닉스	여용환	대리
		와이이케이글래스	박상준	이사
	로봇(4)	디에스티로봇	김연호	상무
		로보스타	주현석	전무
		유니버셜로봇	이용상	대표
		티로보틱스	이수종	부사장
공급기업	반도체(2)	다모아텍	정후민	대표
		동운아나텍	박진	이사
	디스플레이(1)	에스에프에이	하해동	팀장
	임베디드SW(5)	서우엠에스	심상완	대표
		한컴MDS	김동경	상무
		GKeS	박종섭	사장
		원더풀플랫폼	구승엽	대표
		엔젤로보틱스	정성훈	이사
	센서(3)	다인인더스	안종찬	CTO
		아이쓰리시스템	배수호	상무
		코리아스펙트랄프로덕츠	이창석	대표
참여기관	한국기계산업진흥회		정경수	상무
	한국로봇산업협회		조영훈	이사
	한국반도체산업협회		이민영	본부장
	한국디스플레이산업협회		서광현	부회장
	임베디드SW·System산업협회		문정현	상무
	한국산업기술평가관리원		소순종	단장
	경희대학교		임성수	교수
주관기관	전자부품연구원		김영삼	원장
			강병모	본부장
			정일균	센터장